

性能特点

- 具有良好的导热性
- 单组分加热固化，便于操作
- 固化过程无副产物释放
- 优越的耐高低温、耐气候及介电性能
- 固化前有良好的触变性和粘性，接触热阻低，不任意流动，固化后柔软且应力小，无渗出物
- 器件使用后可重工

产品描述

PAKCOOL® TC-9110-T 是可重工单组份加成型加热固化液态膏状导热填缝剂。固化前为液态膏状，可通过自动化点胶、丝网印刷等多种操作方式施工于发热面和散热面之间，与界面有非常好的接触性，经过高温固化形成柔软的凝胶状产品，不仅应力小，而且具有更加优异的使用稳定性。本产品既克服了湿气固化产品的固化时间长的缺点，同时又兼具了硅脂或导热泥非固化型产品的低应力和可重工性，便于后期的维护和修复；亦可称为可自动点胶的导热垫片，比导热垫片操作方便、接触热阻低，相同导热系数可以使器件温度更低，同时能够填充缝隙大且极不平整的界面。

本产品还具有导热性能高、绝缘性能好以及填充间隙大等优点，可广泛用于各种领域有导热需求的电子器件。

典型应用

- 功率模块
- 集成芯片
- 电源模块
- 车用电子产品
- 控制器
- 通讯设备
- 计算机及其附件

注意事项

- 如客户需要更详细的说明，请与我公司市场销售部联系。他们会随时为您解答和服务。

技术参数

| 特性 | TC-9110-T | 测试方法 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 外观 | 白色 | Visual |
| 粘度 (cP) | 95 万±35 万 | ASTM D2196-15 |
| 导热系数 (W/m·K) | 1.0 | ASTM D5470 |
| 密度 (g/cm ³) | 2.60±0.20 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore OO) | 35±25 | ASTM D2240 |
| 介电强度 (kV/mm) | ≥8 | ASTM D149 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | ≥1.0×10 ¹² | ASTM D257 |
| 储藏时间 (@≤25°C) | <6 months | -- |
| 连续使用温度(°C) | -50~+200 | -- |

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

使用方法

- 涂胶前，元器件表面应保持清洁。
- 使用时带防护眼镜和防护手套，使用环境需通风。
- 产品接触有些物质可能会不固化或不完全固化，这些物质包括：硫、磷、氮的化合物如聚砷、聚硫醚、聚氨酯、含酰胺、胺的物质，含锡、砷、锑、硒、碲成分的物质及一些不饱和的碳氢化合物及增塑剂等。

包装储运

- 本产品可提供 30mL、55mL 点胶针筒，330mL 胶瓶，或根据客户要求定制包装。
- 本产品为无毒、不燃材料，室温下的储存期约 6 个月。该产品在使用前可能会有轻微的渗油现象一般不影响使用，应水平停放，尽量在 3 个月内使用。同时低温存储 (<0°C) 有助于改善渗油，根据支装的大小用前在使用环境回温 2-8 小时或以上即可使用。
- 该产品可在常温下作为普通化学品运输。

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。